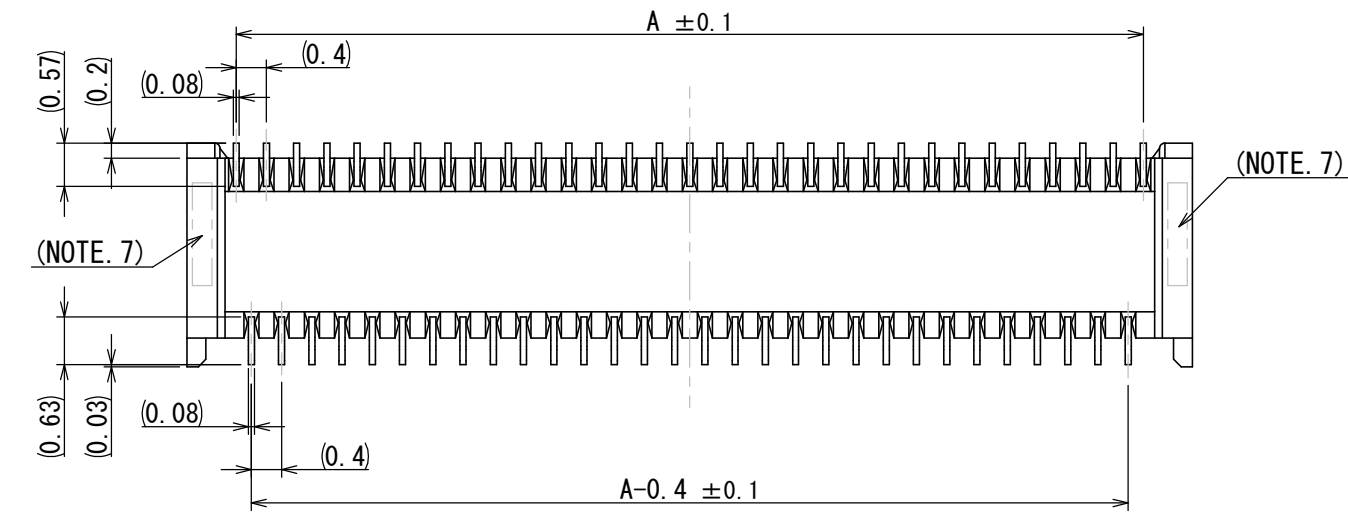
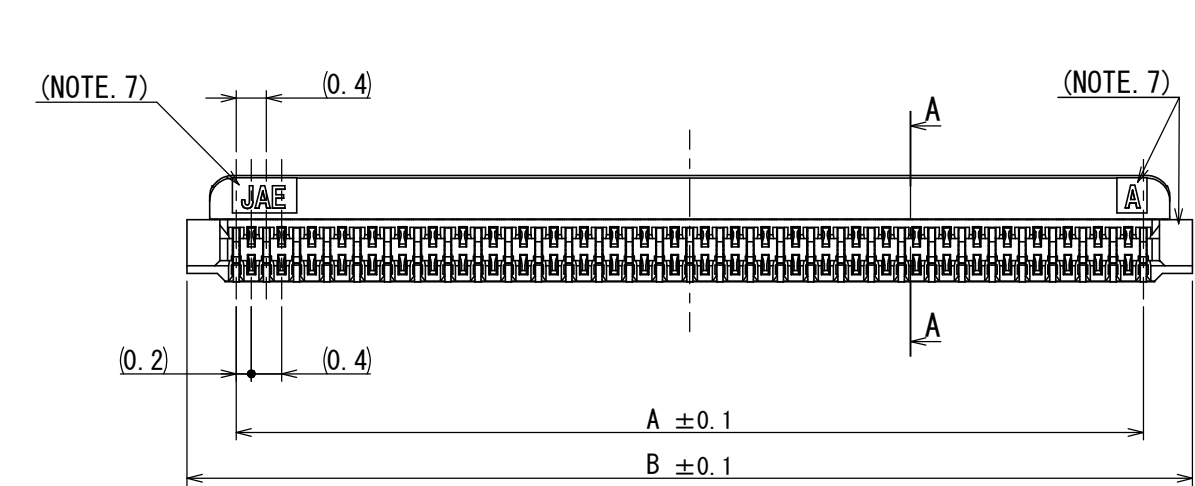
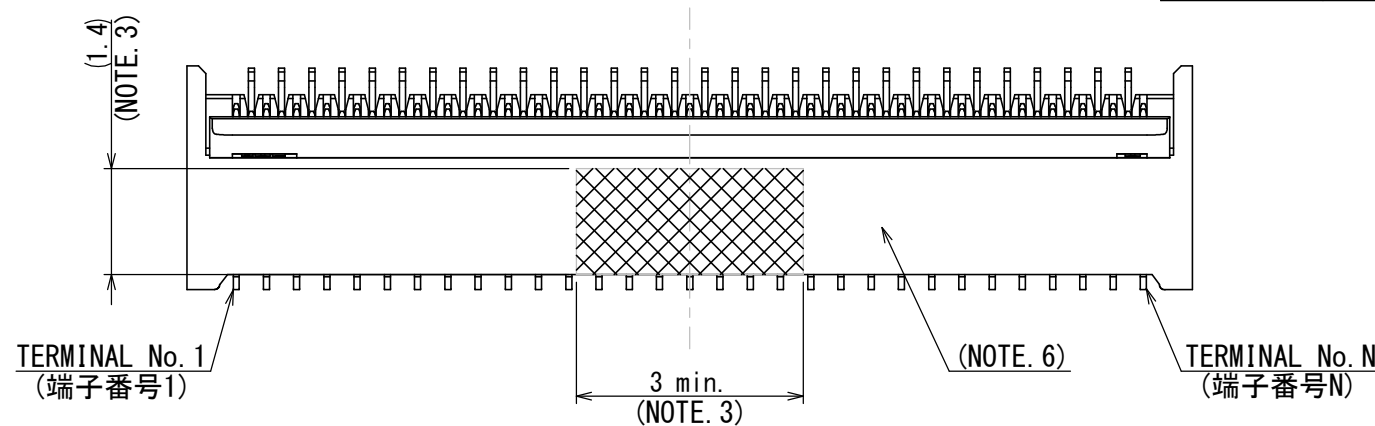


TABLE 2. DIMENSIONS

PIN COUNT	A	B
23	4.4	5.7
41	8.0	9.3
45	8.8	10.1
51	10.0	11.3
61	12.0	13.3

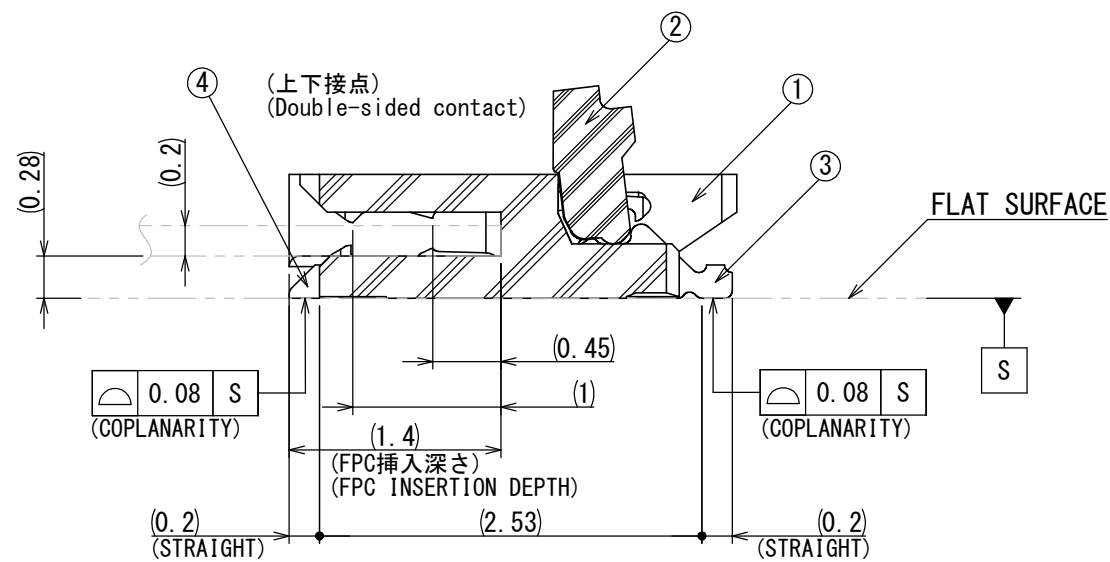
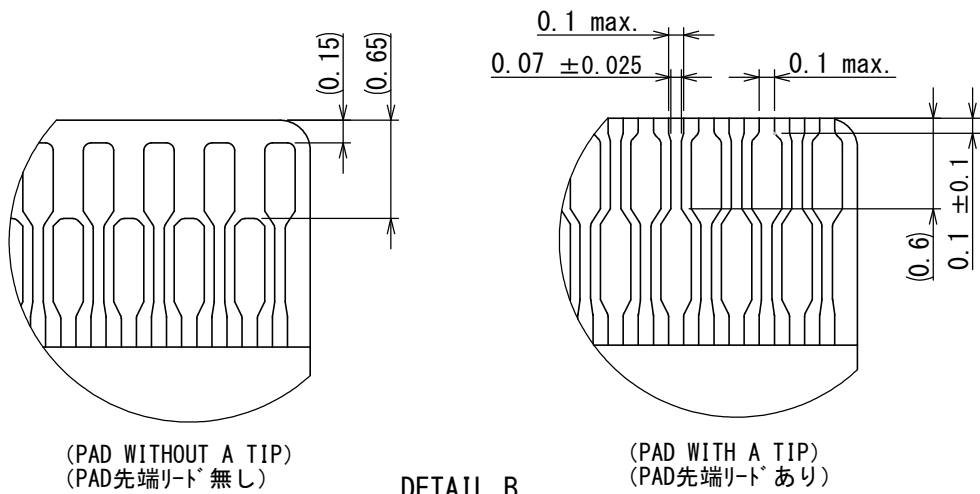
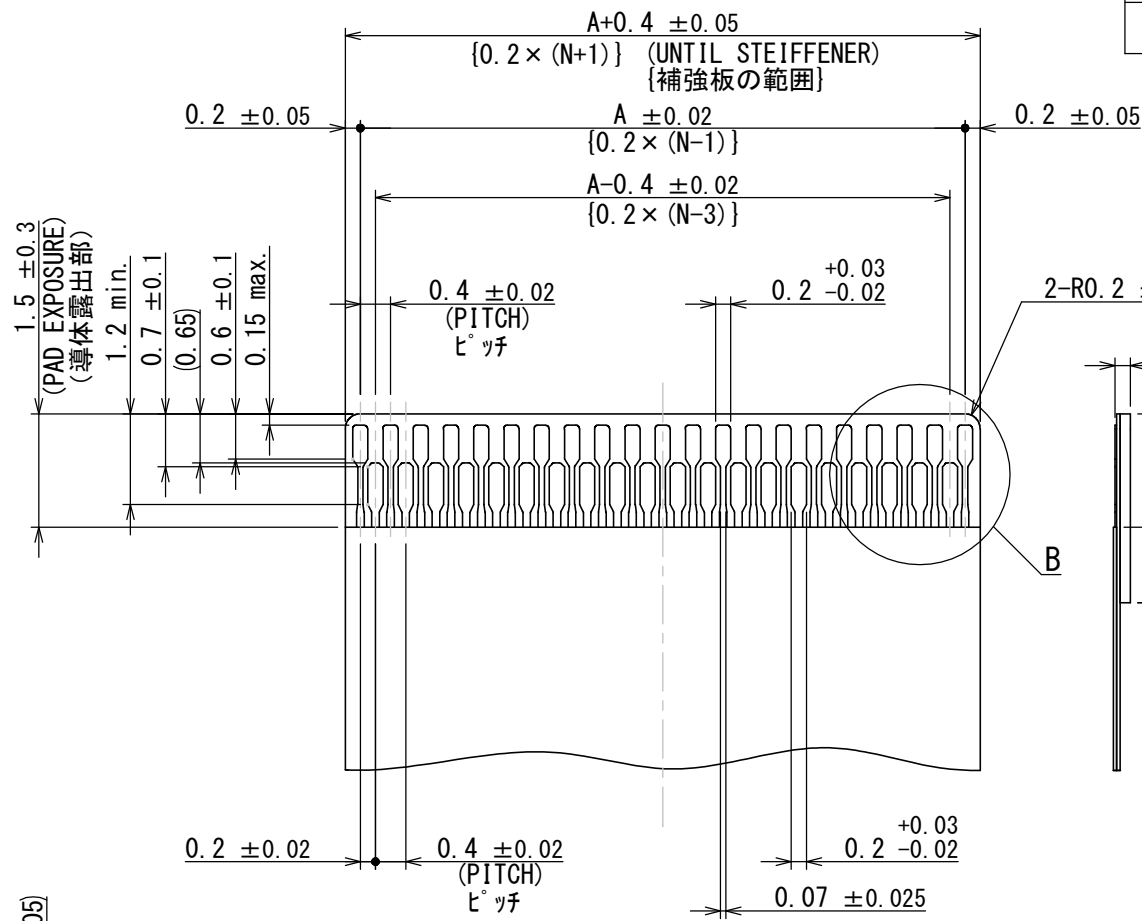


- NOTE
- REFER TO TABLE1 FOR RECOMMENDED FPC COMPOSITION.
 - A NICKEL BARRIER EXISTS BETWEEN CONTACT POINT AND TAIL.
 - THE DIMENSIONS OF VACUUMING COVER AREA.
 - RECOMMENDED F.P.C. PUNCHER DIRECTION ARE FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER FILME SIDE.
 - IN THIS RANGE, WIRING OF A PATTERN IS FORBIDDEN EXCEPT FOR THE PATTERN ELECTRICALLY CONNECTED WITH PAD WHICH EACH RANGE TOUCHES.
 - LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP PORTION OF THE CONNECTOR.
 - THE FOLLOWING ITEMS ARE OPTIONAL: THE DIRECTION AND FORM OF THE COMPANY TRADE MARK, CONFIGURATION AND FORM OF TOOLING ID MARK, AND THE NUMBER AND CONFIGURATION OF SINK-PREVENTING HOLE.
 - THIS PRODUCT IS HALOGEN-FREE

- 注記
- 推奨FPC構成はTABLE1参照のこと。
 - コネクタ接点とSMT部の間にはニッケルバリアがあります。
 - 吸着エリアを示す。
 - FPCの金型抜き方向は、導体側から補強板側を推奨します。
 - この範囲では、それぞれの範囲が接するパッドと電気的に接続されるパターンを除いて、パターンの配線は禁止となります。
 - ロット番号がコネクタ上面に表記されます。
 - 社標表示部の形状・社標の向き、金型マーク表示部の形状・配置、ひけ防止孔の形状・個数は任意である。
 - 本製品はハロゲンフリー品です。

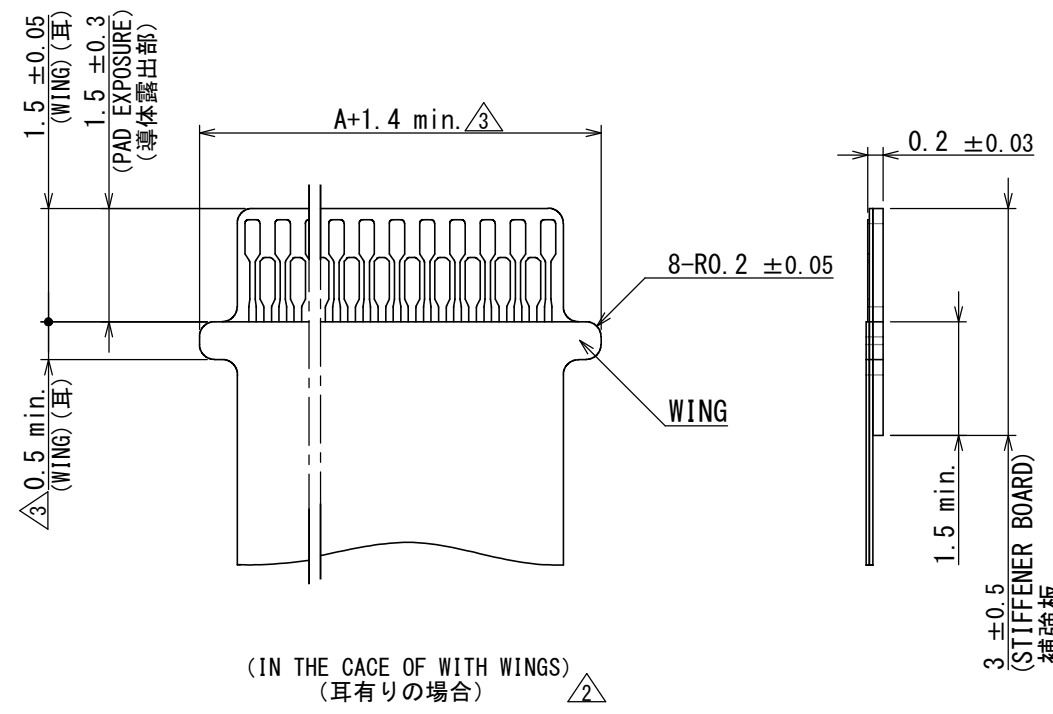
TABLE 1. RECOMMENDED F.P.C. COMPOSITION

COMPOSITION 層名	RECOMMENDED 推奨
GOLD PLATING 金めっき	ELECTROLYSIS PLATING 電解めっき
COPPER 銅箔	ROLLED MATERIAL 圧延銅
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性
BASE FILM ベースフィルム	POLYIMIDE ポリイミド
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性
REINFORCE PLATE 補強板	POLYIMIDE ポリイミド

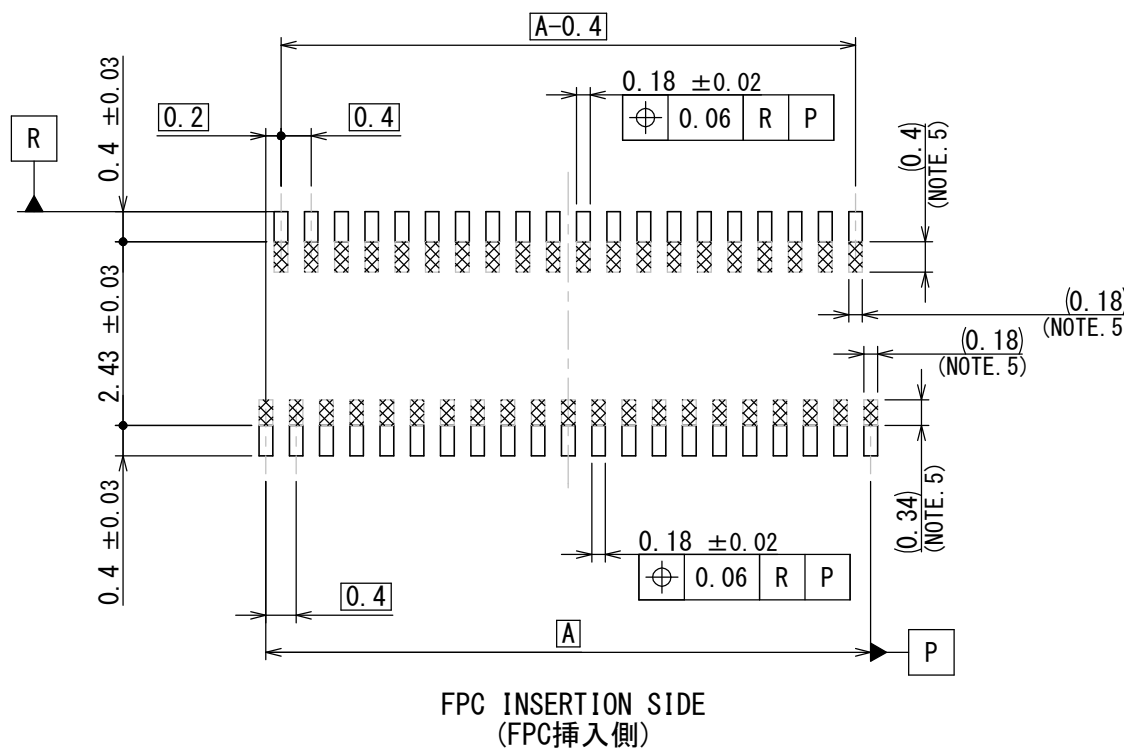


SECT A-A
SCALE (20 : 1)

版数 VER.	年月日 DATE	図 DR.	変更内容 DESCRIPTION	製 DR.	担 CHK.	査 APPD.	承認 APPD.
2	20/JUN/2013	006616	ADDED ITEM. ADDED FIGURE OF APPLICABLE FPC. (REDACTION MARK:3)		K. ASHIBU	H. YOKOO	M. KIKUCHI
3	27/AUG/2013	007323	CHANGED FIGURE OF APPLICABLE FPC. (REDACTION MARK:2)		K. ASHIBU	H. YOKOO	M. KIKUCHI
4	26/FEB/2014	008611	ADDED ITEM. ADDED FIGURE OF APPLICABLE FPC. ETC. (REDACTION MARK:4)		K. ASHIBU	H. YOKOO	M. KIKUCHI



APPLICABLE F.P.C. DIMENSION (REF.)
適合FPC寸法 (参考)



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法 (参考)

4	CONTACT2 コネクタ2	(N+1) 2	PHOSPHER BRONZE りん青銅	PARTIAL GOLD OVER NICKEL (Au0.1 μm MIN.) ニッケル上部分金 (金0.1 μm 以上)	
3	CONTACT1 コネクタ1	(N-1) 2	PHOSPHER BRONZE りん青銅	PARTIAL GOLD OVER NICKEL (Au0.1 μm MIN.) ニッケル上部分金 (金0.1 μm 以上)	
2	ACTUATOR アクチュエータ	1	HEAT RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック		COLOR : NATURAL 色相 : 自然
1	BASE INSULATOR ベースインシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック		COLOR : BLACK 色相 : 黒

仕様書 (SPECIFICATION)	第1版 (ORIGINAL DATE)	尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)	図面番号 (DRAWING NO.)	版数 (VER.)
JACS-10807-*	09/MAY/2013	10:1	FR02	SJ113749	4
JABL-10807					
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	担当 CHK.	K. ASHIBU	名称 (TITLE)		
寸法 (DIMENSION)	査閲 APPD.	H. YOKOO	FR02C0**JA1 (** : Pin count)		
× ± 0.8	承認 APPD.	M. KIKUCHI	質量 (MASS)		
× ± 0.4					
× ± 0.1					
× ±					
単位 (UNIT) : mm					